证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2026-011

深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年4月24日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月14日以电子邮件方式送达至各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

本报告客观、真实地反映了公司总经理2025年度的工作情况。同意《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。同意《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司董事会对公司在任独立董事提交的独立董事独立性自查情况专项报告进行了评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。同意《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。同意《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同意《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

《公司2025年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2025年年度报告》《深圳中科飞测科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

公司编制的《深圳中科飞测科技股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等规则的要求。同意《关于公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案符合公司经营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。同意《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

《2026年度财务预算报告》是公司根据2025年度生产经营和发展计划，以2025年度的经营业绩为基础，本着求实稳健的原则而编制的。同意《关于公司2026年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）在公司财务审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年财务审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对容诚会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。鉴于容诚会计师事务所具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司2025年审计提供了专业的审计服务，在审计工作过程中坚持独立审计原则，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。公司续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构符合《公司法》《证券法》等相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。同意《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

（十四）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2025年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十五）审议通过《关于公司及子公司2026年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》

公司及子公司2026年度向相关金融机构申请授信借款额度事项是综合考虑公司及子公司的经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。同意《关于公司及子公司2026年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次公司为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

（十七）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

预计2026年度日常关联交易额度事项均属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司和上市公司股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈鲁、哈承姝、陈克复对该议案进行回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

（十八）审议通过《关于<公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

该方案有利于进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力，增强投资者权益，提升投资者的获得感，树立良好的资本市场形象。同意《关于<公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十九）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

该方案综合考虑到公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经营收益。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及董事薪酬，公司董事会薪酬与考核委员会所有委员回避表决，直接提交董事会审议，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及高管薪酬，陈鲁、哈承姝、陈克复、周凡女士、古凯男为关联董事，回避该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全董事、高级管理人员激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分闲置募集资金及超募资金（其中拟使用超募资金及其孳息不超过2,000万元）和不超过人民币100,000万元的自有资金（含本数）进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下进行的，有助于提高资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同意《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（二十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募投项目延期，未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（二十四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，由于本次激励计划首次授予及预留授予的激励对象有2名已离职，其已获授但尚未归属的6.2500万股限制性股票不得归属，由公司作废；鉴于有部分激励对象2025年度个人绩效考核结果未达到“卓越（S）/优秀（A+）”，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的12.4000万股限制性股票不得归属，由公司作废。综上所述，本次合计作废的限制性股票数量为18.6500万股。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司董事陈鲁先生、哈承姝女士、周凡女女士、古凯男先生为本次股权激励计划的激励对象，董事陈鲁先生、哈承姝女士、陈克复先生、周凡女女士、古凯男先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（二十五）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为188.8434万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的114名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司董事陈鲁先生、哈承姝女士、周凡女女士、古凯男先生为本次股权激励计划的激励对象，董事陈鲁先生、哈承姝女士、陈克复先生、周凡女女士、古凯男先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（二十六）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年年度股东会，具体召开时间及有关事宜以公司后续发出的股东会通知为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

公司代码：688361 公司简称：中科飞测

深圳中科飞测科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十九次会议决议，基于公司所处的发展阶段、未来研发投入等资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，为进一步推动公司的长期经营发展，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中科飞测	688361	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	古凯男	无
联系地址	深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园1301号	无
电话	0755-26418302	无
传真	0755-23199950	无
电子信箱	IR@skyverse.cn	无

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主营业务概述

报告期内，中科飞测专注于高端半导体质量控制领域，为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。

在设备产品方面，公司凭借过往在光学检测技术、大数据检测算法和自动化软件领域的自主研发和不断创新，在多项半导体质量控制设备关键核心技术上达到国际领先水平，形成了集成电路制造过程中所有关键工艺环节所需的主要种类设备产品组合，使得公司能够为不同类型的集成电路客户提供全面覆盖的检测和量测设备供应保障，支持客户的量产工艺需求和未来工艺研发需求；

面向新的技术趋势与市场需求，2025年，公司在全面覆盖晶圆制造光学检测与量测设备种类的基础上，正式推出多款基于电子束及X光技术的新产品。这些产品与原有光学设备形成优势互补，使得公司能够为先进逻辑、先进存储以及HBM 2.5D/3D封装等前沿领域客户提供覆盖“光学+电子束+X光”三大核心技术路线的一站式良率管理解决方案。

在智能软件产品方面，公司将人工智能和大数据技术应用到半导体质量控制数据上，形成了一系列提升高端半导体制造良率的软件产品，这些软件产品能够在检测和量测设备的基础上进一步为客户在良率管理中赋能，形成完整的质量控制设备和智能软件相结合的良率管理闭环，为客户实现最大化的质量控制对良率管理的提升效果。

2、公司主要产品情况

报告期内，公司专注于高端半导体质量控制领域，主要产品涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。

（1）检测设备

公司检测设备的主要功能系检测晶圆表面或电路结构中是否出现异质情况，如颗粒污染、表面划伤、开短路等对芯片工艺性能具有不良影响的特征性结构缺陷，具体情况如下：

产品名称	图示	产品性能
无图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于硅片的出厂品质管控、晶圆的入厂质量控制、半导体制程工艺和设备的污染监控。该系列的设备能够实现无图形晶圆表面的缺陷计数，识别缺陷的类型和空间分布。
图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于晶圆表面亚微米量级的二维、三维图形缺陷检测，能够实现在图形电路上的全类型缺陷检测。拥有多模式明/暗照明系统、多种放大倍率镜头，适应不同检测精度需求，能够实现高速自动对焦，可适用于面型变化较大翘曲晶圆。
明场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于晶圆表面多种节点的图形晶圆的明场缺陷检测，拥有多模式照明系统、成像系统，多种放大倍率切换，适应不同检测精度和速度需求，能够实现高速自动对焦，可适用于不同类型晶圆。
暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于复杂图形晶圆表面纳米量级缺陷检测，采用深紫外激光暗场扫描与成像探测技术，实现复杂图形晶圆表面缺陷的快速检测与分类功能。

（2）量测设备

公司量测设备的主要功能系对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出量化描述，如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌、套刻精度等物理性参数的量测。在精密加工领域，量测设备主要功能是精密结构件的三维尺寸量测，具体情况如下：

产品名称	图示	产品性能
三维形貌量测设备系列		主要应用于晶圆上纳米级三维形貌测量、线宽测量和TSV孔测量，配合图形晶圆智能化特征识别和流程控制、晶圆传片和数据通讯等自动化平台。
介质膜厚量测设备系列		主要应用于晶圆上纳米级单/多层薄膜、光刻胶等厚度测量，采用椭圆偏振技术和光谱反射技术实现高精度薄膜膜厚、n-k值的快速测量。
金属膜厚量测设备系列		主要应用于晶圆上金属膜厚度和硬掩膜层厚度测量，采用飞秒超声和差分技术，实现高精度膜厚、声速和泊松比的快速测量。
套刻精度量测设备系列		主要应用于电路制作中不同层之间图案对图案对齐的误差测量，并将数据反馈给光刻机，帮助光刻机优化不同层之间的光刻图案对齐误差，从而避免工艺中可能出现的问题。
光学关键尺寸量测设备系列		主要对集成电路前道制程中的扩散、薄膜沉积、研磨、刻蚀、光刻等工艺中的关键尺寸进行高精度和高速度的测量
晶圆平整度量测设备系列		主要应用于有图形/无图形晶圆的几何与纳米形貌的高精度测量，同时支持键合后晶圆、化合物半导体衬底（SiC/GaAs）的全参数检测。
电子束关键尺寸量测设备系列		主要应用于先进逻辑及存储芯片制造，可在纳米乃至亚纳米尺度下对光刻及刻蚀等关键工艺后的特征尺寸进行快速、精准测量。
高深宽比刻蚀结构量测设备系列		主要应用于先进存储芯片制造，基于X光核心技术，可以实现对关键尺寸、高深宽比结构尺寸以及倾斜度等尺寸进行精确、无损量测。
硅通孔铜填充空隙量测设备系列		主要应用于先进封装和HBM芯片制造，基于X光核心技术，可以实现对亚微米级硅通孔铜填充空隙的高分辨、快速、无损量测。
3D曲面玻璃量测设备系列		主要应用于3D曲面玻璃等构件的轮廓、弧高、厚度、尺寸测量，采用光谱共焦技术，实现高精度、高速度的非接触式测量。搭载可配置的全自动测量软件工具和完整的测试及结果分析界面。

（3）良率管理软件

公司将人工智能和大数据技术应用到半导体质量控制数据上，形成了一系列提升高端半导体制造良率的软件产品，这些软件产品能够在检测和量测设备的基础上进一步为客户在良率管理中赋能，形成完整的质量控制设备和智能软件相结合的良率管理闭环，为客户实现最大化的质量控制对良率管理的提升效果，具体情况如下：

产品名称	图示	产品性能
良率管理系统		通过综合运用统计分析和人工智能技术，以及可以根据客户需求定制化的软件工作流，为客户提供包括全维度数据管理、缺陷分类和统计分析、智能根因分析、虚拟量测、交叉分析和良率预测等在内的良率管理功能
半导体缺陷自动分类系统		通过对接客户产线上的所有缺陷检测设备，将设备获取到的缺陷数据按照缺陷的尺寸、形态、位置、聚类情况、整体分布特征等进行自动分类，并且能够追踪和统计缺陷的发生频率和条件，帮助在缺陷层面管理和控制良率
光刻套刻分析反馈系统		实现对光刻机、套刻精度量测设备、晶圆翘曲量测设备、电子束关键量测设备等多种类、多品牌机型的数据进行整合分析和建模，帮助客户及时监控和优化光刻工艺的偏差，同时通过高阶模型补偿等功能来实现对光刻机光刻套刻偏移量的准确控制，有效地提升光刻机光刻工艺的良率水平

自成立至今，公司始终坚持自主研发和自主创新原则，持续提升技术创新与产品创新能力，未来将继续深耕集成电路领域，以行业前沿技术与市场需求为导向，不断丰富产品种类及拓宽产品市场覆盖广度和深度。随着公司业务不断扩大，公司产品种类持续增加。

2.2 主要经营模式

（1）研发模式

公司始终坚持自主研发、自主创新的研发模式，已逐步构建起了一套集研发、生产、销售于一体的创新机制。公司研发以设备研发和相关研发测试平台为载体，协同推进公司高端半导体质量控制设备的研发及产业化进程。

1）设备研发项目

公司设备研发项目流程可以大致分为四个阶段，概念与可行性阶段、Alpha阶段、Beta阶段和量产阶段。

2）研发测试平台项目

研发测试平台是指除设备研发项目外开展的其他研发活动，主要包括前瞻性技术研发、设备优化研发及关键模块研发等。

（2）采购模式

公司主要根据生产计划、物料清单和零部件的库存情况确定零部件的采购计划，并按照采购计划进行采购。

公司的采购流程如下：①设备生产阶段所需物料由制造中心根据生产需求制定物料清单，提交至物控部审核；②物控部结合物料清单以及零部件的库存确定物料采购清单，并提交至采购部执行，采购部负责与供应商接洽、确定采购合同细节；③原材料交付后，针对不同类型的原材料，由品质部门负责原材料的质量检测；④入库完成采购。

（3）生产模式

报告期内，公司主要根据销售订单及销售预测进行生产。

公司市场部负责市场研判并接收客户需求，市场部根据客户需求向部立项后，由总经理审批，审批通过后由物控部安排采购计划并由采购部执行采购。制造中心根据物料到达时间、订单交付时间等制定生产计划和安排生产。制造中心对装配调试后的成品进行检验，检验合格后成品入库。

报告期内，公司将少量辅助性的设备配件组装、加工或清洗业务通过外协加工完成。

（4）销售模式

公司主要产品为检测和量测设备，公司产品和服务主要以直销模式进行，即由公司直接将产品销售给客户。公司市场部负责市场开发、产品的销售，同时，由客户服务部负责公司产品客户支持工作。

报告期内，公司获取订单的方式主要包括与潜在客户商务谈判、招投标和委托代理商推广。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司隶属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”。

（1）行业的发展阶段

全球半导体产业产能持续扩张，推动半导体设备需求持续增长。根据SEMI预测报告，2024年全球半导体制造产能预计同比增长6%，并将在2025年进一步实现7%的增长，达到每月晶圆产能3,370万片的历史新高（以200mm当量计算），带动全球半导体设备销售额也呈现出稳步上升的趋势。根据SEMI报告，2025年全球半导体设备销售额达到1,350.6亿美元，同比增长超过15%，并预计2026年、2027年有望继续攀升至1,450亿和1,560亿美元。

在经历了美国至日本，日本至韩国和中国台湾的两次产业转移后，目前全球半导体产业正向中国大陆加速转移，中国成为全球最大的集成电路生产和消费国。受益于国内晶圆厂扩产能持续扩张，中国大陆的半导体设备行业正处于快速发展期，根据SEMI报告，2025年度中国大陆地区半导体设备销售额达到493.1亿美元，占全球市场的份额超过36%，自2020年以来连续六年成为全球第一大半导体设备市场。

另一方面，目前全球半导体设备市场仍处于寡头垄断局面，以应用材料、阿斯麦、拉姆研究、东京电子、科磊半导体等为代表的国际知名半导体设备企业占据了全球市场的主要份额。近年来，由于全球供应链的紧张和国际贸易摩擦，国内半导体行业越来越意识到半导体设备国产化的重要性，产业链上下游的协同发展更加紧密。凭借区位、定制化服务以及供应稳定性等优势，未来国内半导体设备厂商的市场份额将有望大幅提升。

（2）基本特点

半导体设备是整个半导体产业的重要支撑，半导体产业的快速发展不断推动着半导体设备市场规模的扩大。晶圆厂的主要投资会用于购买生产各类半导体产品所需的关键设备，如光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、质量控制设备、清洗设备、化学研磨CMP设备、离子注入设备等，这些半导体设备应用在半导体制造的核心工艺中，包括光刻、刻蚀、薄膜生长、质量控制、清洗、抛光、离子注入等。半导体设备处于半导体产业链上游的关键位置，先进的半导体设备对先进制程的推进有着至关重要的作用。半导体设备种类众多，涉及技术领域广，需要长期的研发投入以实现技术突破，其先进性直接影响下游客户的产品质量和生产效率，因此在规模化量产前需经过严格的测试以及客户验证，设备的验证壁垒高。同时，为了更好匹配下游客户的工艺提升，半导体设备的技术更新和产品迭代速度需与之保持同步甚至超前。

（3）主要技术门槛

公司所处行业作为典型的技术密集型行业，涉及光学、算法、软件、机电自动化控制等多学科、多领域知识的综合运用，具有较高的技术和客户验证壁垒。因此，新进入企业通常需要经过相对较长时间的研发积累、市场培育推广、客户验证等，较难在短时间内迅速形成市场竞争力。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司所处的半导体检测和量测设备行业

半导体设备分类由半导体制造工艺衍生而来，从工艺角度看，主要可以分为：光刻、刻蚀、薄膜生长、质量控制、清洗、抛光、离子注入等环节。

根据检测类型的不同，应用于前道制程和先进封装的半导体质量控制根据工艺可细分为检测（Inspection）和量测（Metrology）两大环节，检测指在晶圆表面上或电路结构中，检测其是否出现异质情况，如颗粒污染、表面划伤、开短路等对芯片工艺性能具有不良影响的特征性结构缺陷；量测指对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出的量化描述，如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌等物理性参数的量测。半导体质量控制设备可相应分为检测设备和量测设备。

检测和量测设备对芯片生产良率的影响至关重要。随着技术的进步发展，集成电路前道制程的步骤越来越多，工艺也更加复杂。28nm工艺节点的工艺步骤有数百道工序，由于采用多层套刻技术，14nm及以下节点工艺步骤增加至近千道工序。根据YOLE的统计，工艺节点每缩减一代，工艺中产生的致命缺陷数量会增加50%，因此每一道工序的良品率都要保持在非常高的水平才能保证最终的良品率。当工序超过500道时，只有保证每一道工序的良品率都超过99.99%，最终的良品率方可超过95%；当单道工序的良品率下降至99.98%时，最终的总良品率会下降至约90%，因此，制造过程中对工艺窗口的挑战要求几乎“零缺陷”。检测和量测环节贯穿制造全过程，是保证芯片生产良品率非常关键的环节。随着制程越来越先进、工艺环节不断增加，行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求，制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。

（2）全球半导体检测和量测设备的市场格局

根据YOLE数据统计，2025年全球检测和量测设备市场规模达到190.9亿美元，呈现国外设备企业高度垄断的格局。其中，以美国企业科磊半导体为首的前五大海外设备企业合计市场份额占比超过70%。

根据VLSI数据统计，2024年全球半导体检测和量测设备市场中，检测设备占比为69.3%，包括纳米图形晶圆缺陷检测设备、无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备等；量测设备占比为29.0%，包括关键尺寸量测设备、套刻精度量测设备、薄膜膜厚量测设备、三维形貌量测设备等。

序号	设备类型	销售额（亿美元）	占全球总销售额比例
1	明场纳米图形晶圆缺陷检测设备	27.9	19.4%
2	掩膜版缺陷检测设备	18.1	12.6%
3	图形晶圆缺陷检测设备	14.6	10.2%
4	无图形晶圆缺陷检测设备	14.4	10.0%
5	光学关键尺寸量测设备	13.0	9.1%
6	暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备	10.5	7.3%
7	套刻精度量测设备	9.1	6.3%
8	电子束关键尺寸量测设备	8.7	6.1%
9	电子束缺陷检测设备	7.7	5.4%
10	电子束缺陷复查设备	6.2	4.3%
11	晶圆介质薄膜量测设备	4.7	3.3%
12	X光量测设备	3.4	2.4%
13	掩膜版关键尺寸量测设备	1.4	1.0%
14	三维形貌量测设备	0.7	0.5%
15	晶圆金属薄膜量测设备	0.6	0.4%
16	其他	2.5	1.7%
合计		143.5	100.00%

数据来源：VLSI

（3）中国半导体检测和量测设备市场格局

近年来，得益于中国半导体全行业的蓬勃发展和国家近年来对半导体产业持续的政策扶持，行业下游晶圆厂在关键工艺节点上持续推进，多家国内领先的半导体制造企业进入产能扩张期，中国大陆半导体检测与量测设备的市场处于高速发展期。根据YOLE数据统计，2025年中国大陆半导体检测与量测设备市场规模达到44.5亿美